

実装フェスタ関西2024のご案内

【開催概要】



日時：2024年7/4 (木) ~ 7/5 (金)

場所：パナソニックリゾート大阪

大阪府吹田市青葉丘南10-1 TEL 06-6877-0111

分野・競合を超えた技術者間の交流の場を重視。各業界における著名な先生方を講師にお招きし、実装関連技術の将来像を語って頂きます。

HP：<https://www.jiep.or.jp/event/workshop/jfk2024/index.php>

学生参加の優遇

人材育成と若手技術者交流の観点から多くの学生さんの参加を期待。学生参加費を従来以上に優遇（0円～）

スポンサーセッション

スポンサー企業の保有する技術や会社を紹介するセッションを開催。セッション参加学生には、特典【2日目の昼食クーポン進呈】を準備（上限あり）

プログラム

※下記の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

基調講演 7/4 (木)

「IOWNを支える光電融合デバイスの進化」

塚野 英博 氏 (NTT)

招待講演 7/4 (木)

「EV、PHV向けパワー半導体に求められる技術要件を共に考える
～前工程からシステム出口までオールジャパンで半導体応用開発を加速させるために～」

山本 真義 氏 (名古屋大学)

「エレクトロニクス実装学会における光電融合に向けた取り組み」

那須 秀行 氏 (古河電気工業)

「車載・5G通信で培った部品・コンポーネントを搭載した
超小型人工衛星の宇宙空間での実証」

森 将人 氏 (パナソニック)

「低温焼成が可能な結晶制御された銅ナノ粒子濃厚分散系」

米澤 徹 氏 (北海道大学)

「部品内蔵基板EC2AM:
Embedded Copper Core Advanced Moduleの現状と今後の展開」

五十嵐 優助 氏 (エニマイコンジャパン)

「最近よく聞くESGって何のこと？～ややこしい英語・カタカナ使用禁止ver～」

津田 かおる 氏 (ノーリツ)

特別講演 7/4 (木)

「製造業の次の進化 (AIで激動する製造業がとるべきアクション)」

ものづくり太郎 氏 (ブーステック)

ナイトセッション 7/4 (木)

招待講演のテーマにて、各講師とグループディスカッション

特別対談 7/5 (金)

「分野間コミュニケーション CROSS POINT 2024 ～異分野の理解が技術の進化&深化を促す～」

基調講演 7/5 (金)

「半導体産業の持続的成長に向けて -今、何故「最先端半導体」を選択したか？ -」 東 哲郎 氏 (Rapidus)

「人工知能、ロボット、そして人間」

ハルトノピトヨ 氏 (中京大学)

ポスターセッション 7/5 (金) 48件を予定

第1部_7/5 (金) AM

第2部_7/5 (金) PM